●実装上の注意

1. はんだ条件
   (1) こて付け条件
      (a) +260±5℃の溶解はんだに端子の根元から1.5mmの位置まで10±1.0秒間浸した後、常温に取り出して4時間後に測定する。
      (b) リード部をはんだごて温度+350±5℃で3.0±0.5秒間当て、常温に取り出して4時間後に測定する。
   (2) リフロー条件
      本製品はリフロー方式には対応できません。
2. 本製品は密閉構造ではありませんので洗浄できません。

●定格上の注意

本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。

●取り扱い上の注意

1. 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回路設計には十分ご注意ください。
2. 本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが発生する恐れがありますので、直流電圧をかけないような回路設計を行ってください。
3. IC等により駆動する際、安定鳴動およびIC保護用にIC出力端と本体に直列抵抗約1～2kΩを挿入するか（図1）、本体と並列にダイオードを挿入して、ご使用ください（図2）。

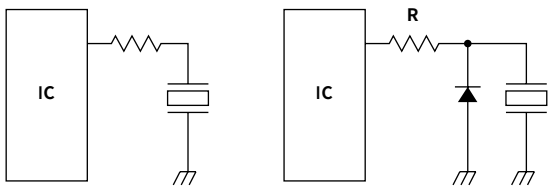

図1　図2

●保管・使用環境

1. 製品保管条件
   温度-10～+40℃、相対湿度15～85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管ください。
2. 製品保管期限
   製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用ください。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認のうえ、ご使用ください。
3. 製品保管上の注意事項
   (1) 酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けてください。
   (2) 湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管ください。
   (3) 直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けてください。
   (4) 開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用ください。
   (5) 製品落下により、製品内部のセラミック素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取り扱いをお願い致します。
4. その他
   ご使用に際し、何か不都合が懸念される場合は、別途、当社までご相談ください。